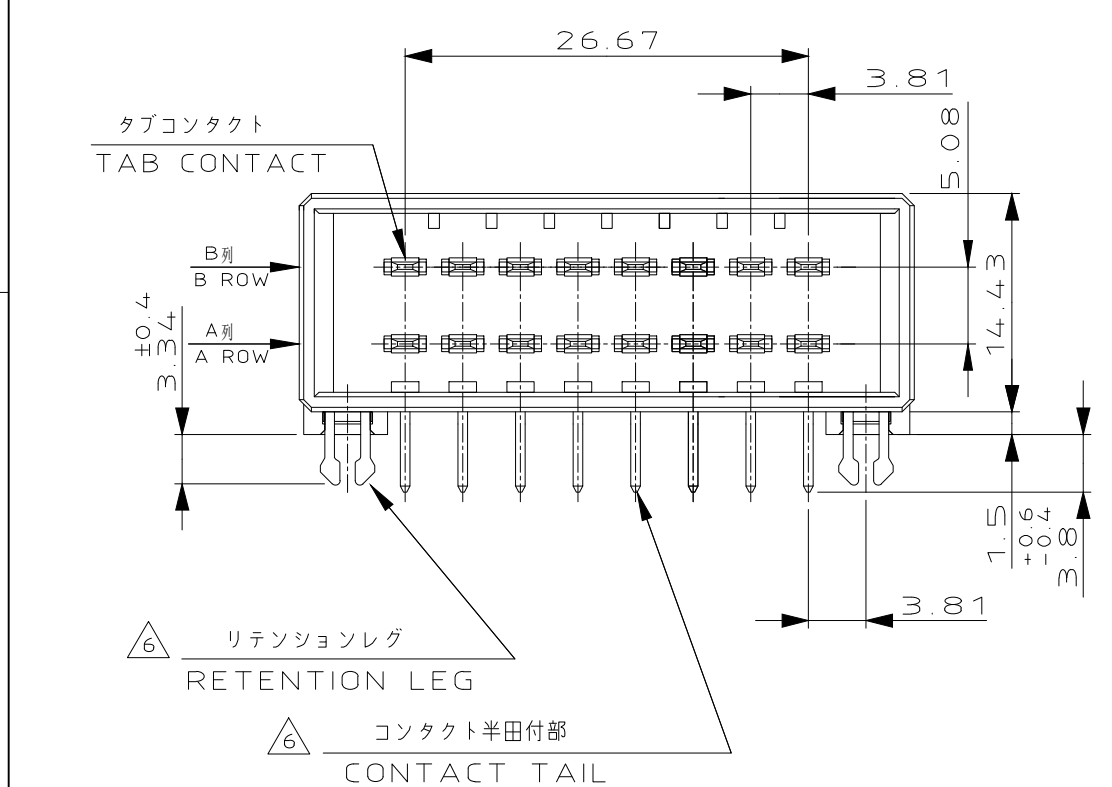
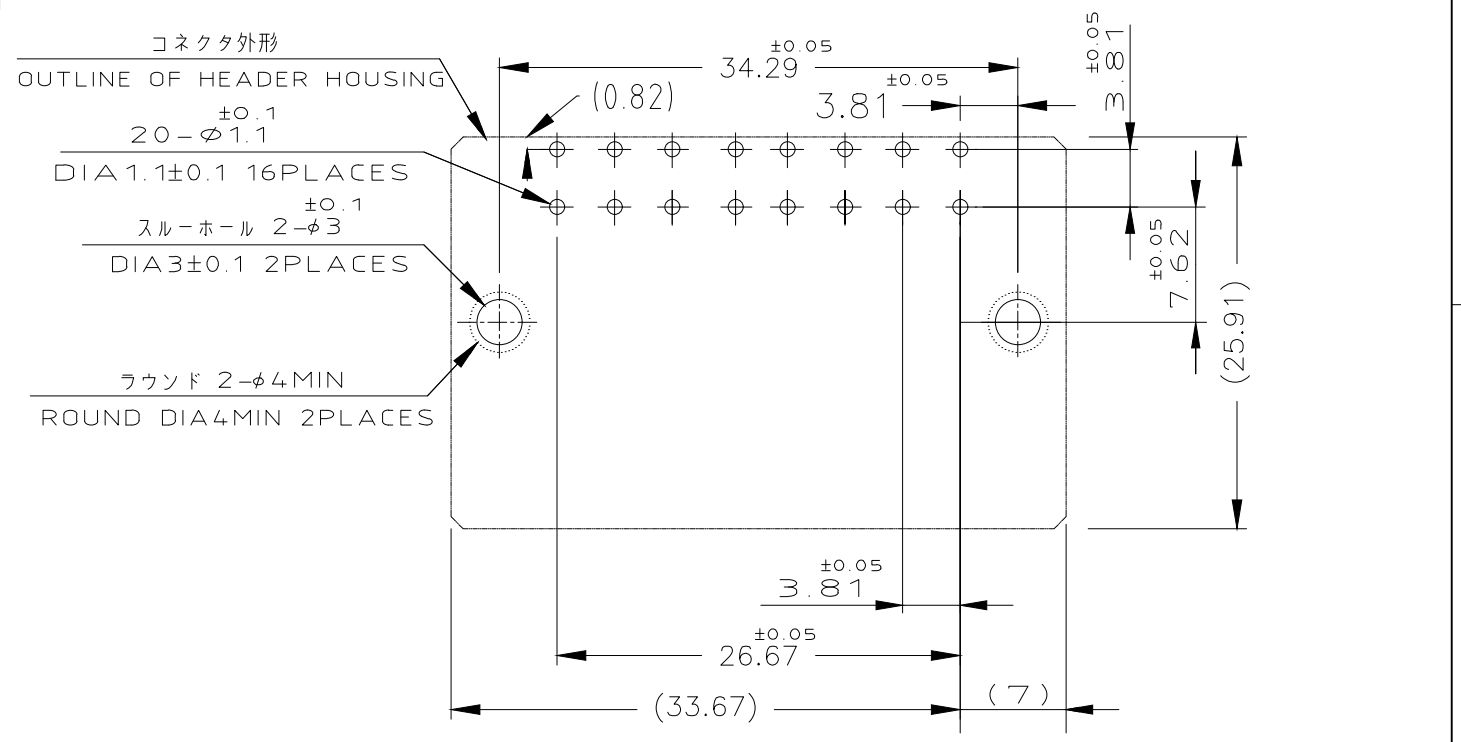
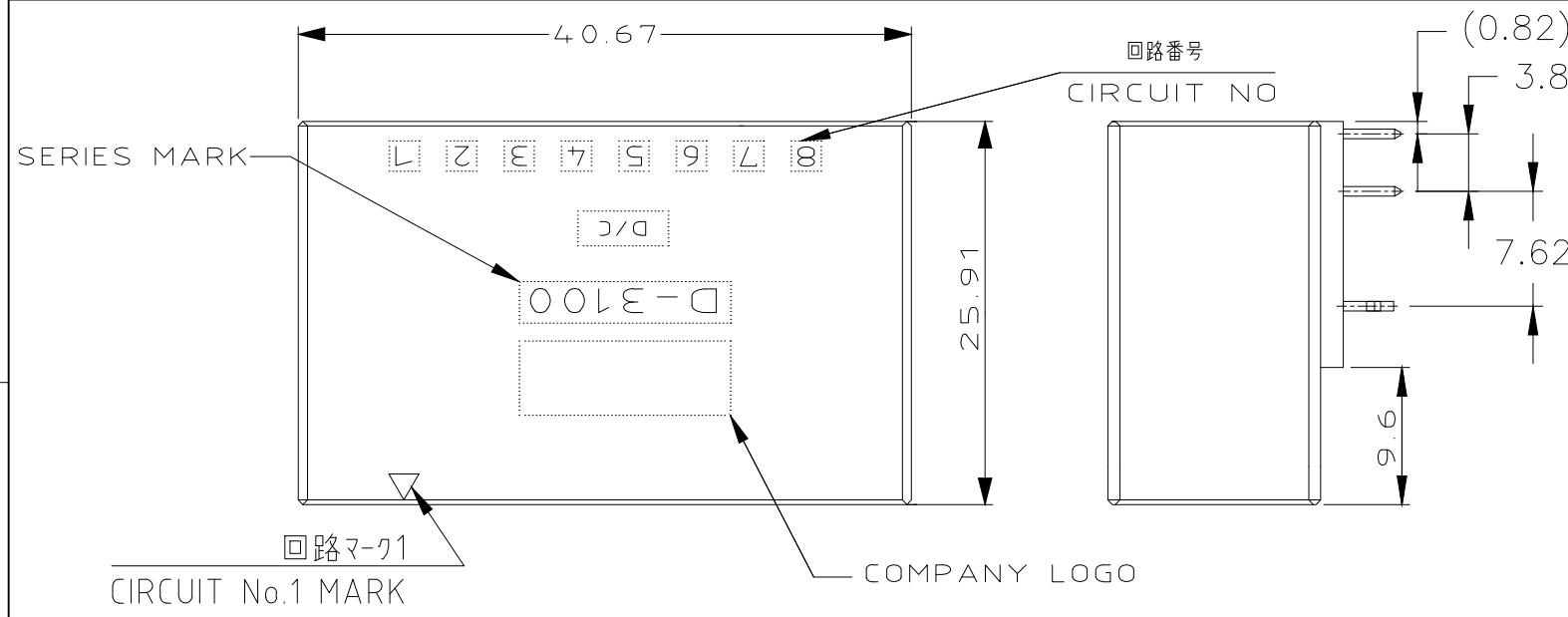


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - Tyco Electronics JAPAN G.K. ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	D2	REVISED PER ECR-18-004413	23MAR2018	K.T	E.I



推奨基板取付け穴寸法
 PC 基板厚: 1.6 ± 0.1
 (非累積公差)
 (コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
 PC BOARD THICKNESS: 1.6 ± 0.1
 (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
 (CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER COLOR: BLACK
 CONTACT: COPPER ALLOY
 RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- GENERAL TOLERANCE
 10 ≥ : ±0.3
 30 ≥ > 10 : ±0.4
 100 ≥ > 30 : ±0.45
 ANGLE : ±3°

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 色: 黒
 コンタクト: 銅合金
 リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
 接触部: 0.38 μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
 接触部: 0.76 μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
 接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
 ニッケル下地の上に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部 : ニッケル下地の上にスズめっき
- 一般公差
 10 ≥ : ±0.3
 30 ≥ > 10 : ±0.4
 100 ≥ > 30 : ±0.45
 角度 : ±3°

△6	△2	178307-6
△6	△4	178307-5
△6	△3	178307-3
△6	△2	178307-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K.IKEDA 16.MAR.95	TE Connectivity Ltd.		
		CHK S.Manabe 23.MAR.95			
		APVD K.Ikeda 13.MAR.95	NAME		
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.		PRODUCT SPEC 108-5349	
MATERIAL SEE NOTE		FINISH SEE NOTE		APPLICATION SPEC 114-5148	
CUSTOMER DRAWING			SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-178307
			SCALE 2:1	SHEET 1 OF 1	RESTRICTED TO REV D2